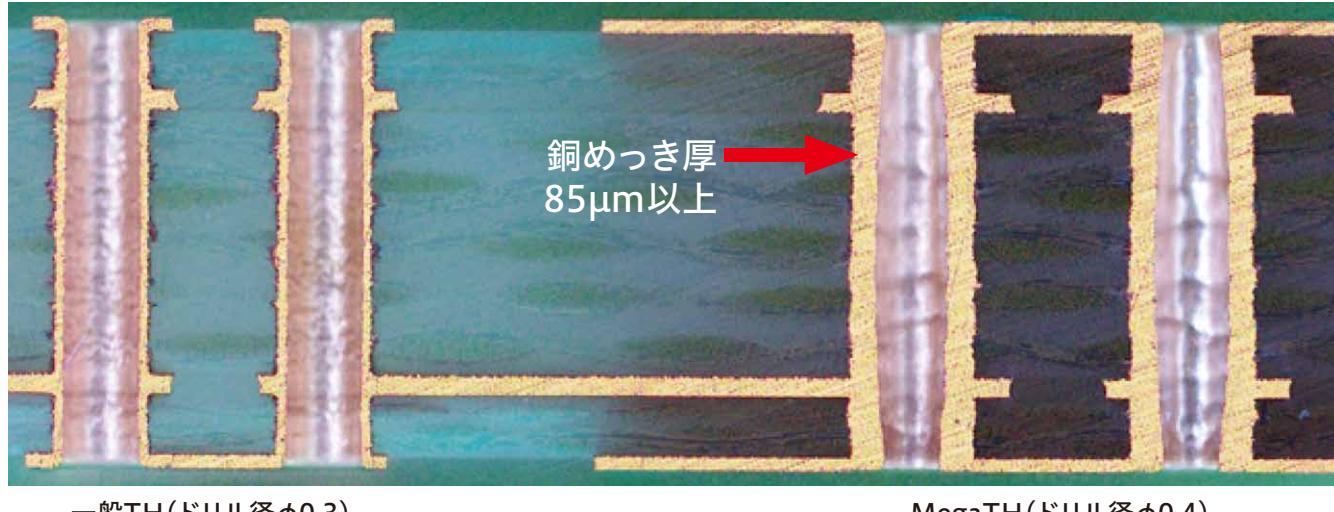


メガスルホール™

MegaTH™ technology

特長 Features

- 任意のスルホールに対して一般的なスルホールの数倍以上の銅めっき厚を確保。
The thickness of copper plating on any through hole is more than three times that of general through holes.
- 表裏、内層への大電流、伝熱経路を確保。
Secures a large current and heat transfer path to the front and back, inner layers.



一般TH(ドリル径 ϕ 0.3)
銅めっき厚TH穴壁25µm

MegaTH(ドリル径 ϕ 0.4)
銅めっき厚TH穴壁85µm

ラインナップ Lineup	スーパーメガスルホール Super MegaTH	メガスルホールMk.2 MegaTH Mk.2 R&D
構造 Construction	<p>210µm 85µm</p>	<p>50µm 200µm 608µm</p>
特長 Feature	内層厚銅層との接続により放熱性と大電流対応を強化。様々な構造に対応が可能。	TH銅めっき厚200µmへのUPと薄板t0.1mmへ対応した高性能メガスルホールを開発。従来にない画期的な大電流高放熱構造への応用展開が可能。
仕様 Specification	銅めっき厚TH穴壁85µm 内層銅厚210µm	Min板厚0.1mm 銅めっき厚TH穴壁200µm ドリル径0.6mm